

USB3.0A R1V 2.0N3 RL BL



USB - это надежный интерфейс передачи данных для устройства в промышленном применении. Из-за большого количества преимуществ USB-разъемы всегда используются чаще всего в электротехнической промышленности.

Широкий ассортимент компонентов USB-A, -B - C и - Micro обеспечивает проектирование инновационных устройств, поддерживающих скорость до 10 Гбит/с. Наши разъемы USB печатной платы поддерживают надежные стандарты USB 2.0, 3.0 и 3.1 для быстрой и простой передачи данных.

Отдельные соединители соответствуют требованиям относительно высокой прочности и обеспечивают надежное соединение.

- До 10,000 циклов вставки
- Техпроцессы пайки THT, THR или SMD
- Доступны конструкционные типы 180° (вертикальная) или 90° (горизонтальная)
- Размещение в лотке (TY) или рулоне (лента на катушке, RL)
- Усиленный слой золота для улучшенной защиты от коррозии
- Разъемы USB 3.1 поддерживают высокую скорость передачи данных 10 Гбит/с
- Разъемы USB-C обеспечивают безошибочное подключение благодаря симметричной конструкции

- Надежная работа технологии «Включи и работай»: подключение и отключение без завершения работы или перезагрузки системы

Основные данные для заказа

| | |
|-----------------|---|
| Версия | Данные OMNIMATE – штекер USB, Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Тип A, 5 Гбит/с, Соединение THT/THR под пайку, 180°, Циклы коммутации: ≥ 1500, Количество полюсов: 8, PA 9T, Золото поверх никеля, Таре |
| Заказ № | 2562980000 |
| Тип | USB3.0A R1V 2.0N3 RL BL |
| GTIN (EAN) | 4050118572001 |
| Кол. | 140 Штука |
| Упаковка | Таре |
| Статус поставки | Снято с производства |

USB3.0A R1V 2.0N3 RL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Глубина | 5.72 mm | Глубина (дюймов) | 0.2252 inch |
| Высота | 17 mm | Высота (в дюймах) | 0.6693 inch |
| Высота, мин. | 15 mm | Ширина | 13.1 mm |
| Ширина (в дюймах) | 0.5157 inch | Масса нетто | 5 g |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Упаковка

| | | | |
|--|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| Упаковка | Tape | Длина VPE | 267.00 mm |
| VPE с | 239.00 mm | Высота VPE | 11.00 mm |
| Диаметр катушки с лентой \varnothing (A) | 330 mm | Поверхностное сопротивление | Rs = 109 - 1012 Ω |

Системные характеристики

| | | | |
|--|---|--|------------------------------|
| Количество полюсов | 8 | LED | Нет |
| Длина штифта для припайки (l) | 2 mm | Монтаж на печатной плате | Соединение THT/THR под пайку |
| Шаг в дюймах (P) | 0.079 " | Материал экрана | Латунь |
| Экранирование | Да | Усилие вставки на полюс, макс. | 35 N |
| Скорость передачи | 5 Гбит/с | Усилие вытягивания на полюс, макс. | 10 N |
| Количество контактных штырьков на полюс | 1 | Вид соединения | Гнездо |
| Серия изделия | Данные OMNIMATE – штекер USB | Шаг в мм (P) | 2.00 mm |
| Вид защиты | IP20 | Циклы коммутации | ≥ 1500 |
| Угол вывода | 180° | Поверхность экрана | никелированный |
| Выводы для экранирования | нет | Категория эксплуатационных характеристик | 5 Gbps |
| Техпроцесс пайки | Пайка оплавлением сквозных отверстий (Reflow), Пайка вручную, Пайка волной припоя | Размеры выводов под пайку | восьмиугольный |
| Допуск на расположение выводов под пайку | $\pm 0,1$ мм | | |

Электрические свойства

| | | | |
|--|----------|------------------------|-----------------------------|
| Электрическая прочность, контакт / контакт | 100 V AC | Сопротивление изоляции | ≥ 500 M Ω |
| Номинальное напряжение | 30 V | Номинальный ток | 1,8 A при 250 В перем. тока |

Данные о материалах

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Изоляционный материал | PA 9T | Цветовой код | черный, синий |
| Таблица цветов (аналогич.) | RAL 9011, RAL 5012 | Группа изоляционного материала | II |
| Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 500 | Сопротивление изоляции | ≥ 500 M Ω |
| Moisture Level (MSL) | 1 | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Основной материал контактов | Фосфористая бронза | Материал контакта | Сплав меди |
| Поверхность контакта | Золото поверх никеля | Структура слоев штепсельного контакта | ≥ 15 μ " Au |

USB3.0A R1V 2.0N3 RL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| | | | |
|----------------------------|--------|-----------------------------|-------|
| Температура хранения, мин. | -40 °C | Температура хранения, макс. | 85 °C |
| Рабочая температура, мин. | -40 °C | Рабочая температура, макс. | 85 °C |

Важное примечание

Примечания

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002637 | ETIM 9.0 | EC002637 |
| ETIM 10.0 | EC002637 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 | | |

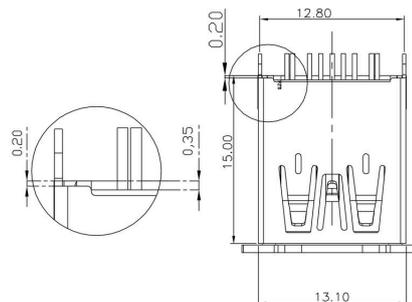
USB3.0A R1V 2.0N3 RL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

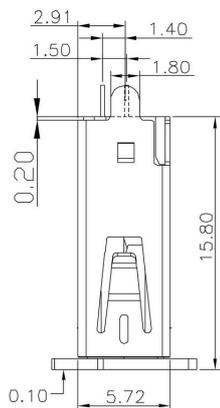
www.weidmueller.com

Изображения

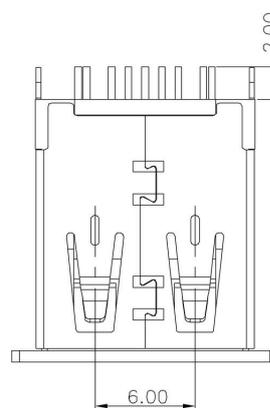
Габаритный чертеж



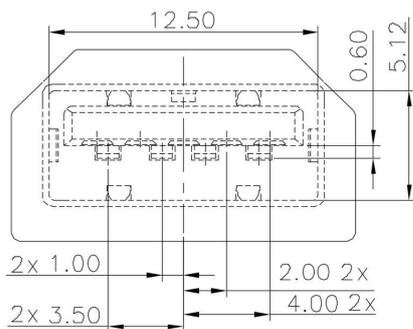
Габаритный чертеж



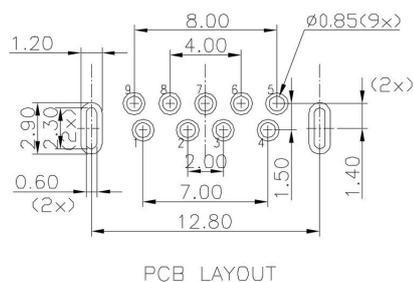
Габаритный чертеж



Габаритный чертеж



Чертеж РСВ платы



PCB LAYOUT

USB3.0A R1V 2.0N3 RL BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Условные обозначения

| USB | 3.0A | R | 1 | V | 3.0 | N | 4 | TY | BL | USB3.0A R1V 3.0N4 TY BL |
|-----|------|---|---|---|-----|---|---|----|----|---|
| | | | | | | | | | | Colour / Special Option |
| | | | | | | | | | | BL blue (plastic) |
| | | | | | | | | | | BK black (plastic) |
| | | | | | | | | | | WH white (plastic) |
| | | | | | | | | | | SO customized product |
| | | | | | | | | | | Packaging |
| | | | | | | | | | | TY Tray in box (manual assembly) |
| | | | | | | | | | | RL Tape on Reel (automated assembly) |
| | | | | | | | | | | TU Tube |
| | | | | | | | | | | Contact surface thickness |
| | | | | | | | | | | 4 1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ" , 5 = 50µ" |
| | | | | | | | | | | Solder Pin length |
| | | | | | | | | | | N no use |
| | | | | | | | | | | 3.2 3.2 mm |
| | | | | | | | | | | 1.6 1.6 mm |
| | | | | | | | | | | D SMD |
| | | | | | | | | | | Direction |
| | | | | | | | | | | H Horizontal (90°, side entry) |
| | | | | | | | | | | U Horizontal, Upright 90° |
| | | | | | | | | | | V Vertical (180°, top entry) |
| | | | | | | | | | | Number of Ports |
| | | | | | | | | | | 1 1 Port |
| | | | | | | | | | | 21; 41; ... multi ports about each other, Multilevel |
| | | | | | | | | | | Assembly on PCB |
| | | | | | | | | | | R Through Hole Reflow - THR |
| | | | | | | | | | | Soldering process: Wave or Reflow soldering |
| | | | | | | | | | | S Surface Mount Technology - SMT |
| | | | | | | | | | | Soldering process: Reflow soldering |
| | | | | | | | | | | T Through Hole Technology - THT |
| | | | | | | | | | | Soldering process: Wave |
| | | | | | | | | | | Type / Performance |
| | | | | | | | | | | 2.0A USB 2.0 Type A |
| | | | | | | | | | | 3.0A USB 3.0 Type A |